Література

- 1. Юткин, Л.А. Электрогидравлический эффект [Текст] / Л.А. Юткин. М.: Машгиз, 1975. 356 с.
- Коробейников, В.П. Определение формы и параметров фронта ударной волны при взрыве в неоднородной среде [Текст] / В.П. Коробейников, В.П. Карликов // Докл. АН СССР. – 1963. – №6. – С. 1271 – 1274.
- Ковальчук, В.В. Внутренняя энергия и давление плазмы в канале электрического разряда [Текст] / В.В. Ковальчук, О.І. Лещенко, О.В. Осипенко // Труды Одесского политехнического университета. – 2008. – Вып. 2(30). – С. 228–234.
- 4. Коробейников, С.М. Зажигание разряда в воде с помощью пузырьков [Текст] / С.М. Коробейников, А.В. Мелехов, А.С Бесов // Теплофизика высоких температур. – 2002. – Т. 40, №5. – С. 120-127.
- 5. Nigmatulin, R.I. Dynamics, heat and mass transfer of vapor–gas bubbles in liquid [Teκcτ] / R.I. Nigmatulin, N.S. Khabeev, F.B. Nagiev // Int. J. Heat Mass Transfer. 1981. Vol.24, №6. Pp.1033–1041.
- Мельников, И.П. Предпробойное развитие электрического разряда в водных электролитах [Текст]: автореф. дис. канд. физ.– мат. наук / И.П. Мельников. – Л., 1969. – 16 с.
- On the pressure developed in a liquid during the collapse of a spherical cavity [Текст] // Phil. Mag. 1917. Vol.34. Pp.94–98.
 Долинский, А.А. Теоретическое обоснование принципа дискретно–импульсного ввода энергии. І. Модель динамики одиноч-
- ного парового пузырька [Текст] / А.А. Долинский, Г.К. Иваницкий // Пром. теплотехника. 1995. Т.17, №5. С. 3–28.
 9. Яхно, О.М. Математична модель динаміки росту парової фази (перенесення теплоти у рідині, зміна зовнішнього тиску, вплив теплофізичних параметрів, поля швидкостей і тиску біля бульбашки) [Текст] / О.М Яхно, В.Р. Кулінченко, В.Л. Зав'ялов, Т.Г. Мисюра // Технологія і техніка друкування. Збірник наукових праць НТУУ «КПІ». 2006. Вип. №3(13). С. 49–58.
- Долинский, А.А. Теоретическое обоснование принципа дискретно–импульсного ввода энергии. П. Модель динамики ансамбля паровых пузырьков [Текст] / А.А. Долинский, Г.К. Иваницкий // Пром. теплотехника. – 1996. – Т.18, №1. – С. 3–20.

УДК 621.383.46

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ТРЕХПЕРЕХОДНЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АМОРФНОГО И МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ

С. Н. Чеботарев Кандидат технических наук, старший научный сотрудник* E-mail: chebotarev.sergei@gmail.com

А.С. Пащенко

Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник* E-mail: as.pashchenko@gmail.com

М. Л. Лунина

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатория солнечной энергетики** E-mail: MarinaSchaz@rambler.ru

В. А. Ирха

Ведущий инженер

Общество с ограниченной ответственностью специальное конструкторско-технологическое бюро «Инверсия» ул. Зорге, 7, г. Ростов-на-Дону, 344000, Россия E-mail: v-irx@rambler.ru

*Лаборатория кристаллов и структур для твердотельной электроники **Южный научный центр Российской академии наук пр. Чехова, 41, г. Ростов-на-Дону, 344006, Россия

Запропонована конструкція тонкоплівкого трьохперехідного фотоперетворювача на основі гідрованих і оксидованих шарів мікро кристалічного і аморфного кремнію α-Si: H(n-i-p)/µc-SiO: H (n-i-p) / µc-Si: H (n-i-p). Результати чисельного моделювання вказують на можливість досягнення 16% ККД

-0 -0-

Ключові слова: трьохперехідний тонкоплівкий фотоперетворювач, аморфний і мікрокристалічний кремній, чисельне моделювання

Предложена конструкция тонкопленочного трехпереходного фотопреобразователя на основе гидрированных и оксидированных слоев микрокристаллического и аморфного кремния α -Si:H(n-i-p)/µc-SiO:H(n-i-p)/ µc-Si:H(n-i-p). Результаты численного моделирования указывают на возможность достижения 16% КПД

Ключевые слова: трехпереходный тонкопленочный фотопреобразователь, аморфный и микрокристаллический кремний, численное моделирование

-0 -0

1. Введение

Фотопреобразователи (ФЭП) на основе моно- и поликристаллического кремния занимают более 85% мирового рынка наземной солнечной энергетики. Наибольшей эффективностью преобразования солнечного излучения обладают монокристаллические кремниевые ФЭП (с-Si) [1]. Основной недостаток с-Si ФЭП заключается в значительном расходе высокочистого монокристаллического кремния, большая часть которого выполняет роль пассивной подложки. Для уменьшения себестоимости кремниевых ФЭП используются микрокристаллические (µс-Si:H) [2] и аморфные (α-Si:H) [3] кремниевые слои-поглотители толщиной 0.1-3 мкм. Ранее нами [4, 5] проведено численное моделирование функциональных характеристик солнечных элементов на основе монокристаллического кремния и А³В⁵. В работе [6] продемонстрирована экспериментальная возможность получения моно- и поликристаллических кремниевых микро- и нанослоев.

2. Цель и задачи исследования

Цель настоящей статьи состоит в численном моделировании трехпереходного ФЭП α-Si:H/µc-SiO:H/ µc-Si:H. Задачами исследования являются: 1) разработка физической модели трехпереходных ФЭП содержащих слои µc-Si:H, µc-SiO:H и α-Si:H; 2) создание компьютерной программы для численного моделирования функциональных характеристик ФЭП; 3) демонстрация возможности повышения КПД ФЭП путем введения гидрированно-окисдированного микрокристаллического слоя кремния.

3. Физическая модель трехпереходных ΦЭΠ α-Si:H/μc-SiO:H/μc-Si:H

Для моделирования характеристик ФЭП на основе µc-Si:H, µc-Si:O и α-Si:H разработана компьютерная программа, работающая в среде MatLab. Подобно имеющимся программам моделирования ФЭП на основе c-Si (например, AMPS-1D [7]) предложенная нами программа также основана на решении системы дифференциальных уравнений, состоящих из уравнения Пуассона, уравнений непрерывности и переноса носителей заряда. Однако при моделировании электрических и фотоэлектрических свойств аморфного и микрокристаллического кремния необходимо учитывать принципиальное отличие свойств этих материалов от свойств монокристаллического кремния. Описанию таких отличий и принятых допущений и будет посвящен настоящий раздел.

Для полноты рассмотрения принятой модели приведем стандартную систему уравнений, используемую для численного моделирования полупроводниковых многослойных электрических устройств [8].

Уравнение Пуассона:

div grad
$$\phi = -\frac{\rho}{\epsilon \epsilon_0}$$
, (1)

где φ – электрический потенциал, ρ – объемная плотность заряда, ε – диэлектрическая проницаемость, ε_0 – диэлектрическая постоянная.

Система уравнений непрерывности для электронов и дырок:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{e} div \ \overline{j}_n \ -R_n + G, \qquad (2)$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{1}{e} \text{div } \overline{j}_p \cdot R_p + G, \qquad (3)$$

где t – время, е – заряд электрона, п и р – концентрации электронов и дырок, \vec{j}_n и \vec{j}_p - плотности электронного

и дырочного тока, R_n и R_p – скорости рекомбинации электронов и дырок, G – скорость генерации электронно-дырочных пар.

Система уравнений переноса для электронов и дырок:

$$\overline{j}_n = -en\mu_n grad \phi + eD_n grad n$$
, (4)

$$j_p = -ep\mu_p \text{grad } \phi - eD_p \text{grad } p$$
, (5)

здесь μ_n и μ_p – подвижности электронов и дырок в слоях, D_n и D_p – коэффициенты диффузии электронов и дырок.

Для решения уравнений (1) - (5) необходимо кроме граничных условий определить плотности состояний g(E) в аморфном и микроскристаллическом кремнии, а также процессы фотогенерации и рекомбинации носителей заряда, в том числе и на границах контактирующих слоев.

Электрические и оптические свойства кристаллических материалов зависят от плотности энергетических состояний g(E), определяемой параметрами решетки и типом атомов. В аморфных материалах кристаллическая периодичность отсутствует. Зонная структура α-Si:Н отличается от зонной структуры монокристаллического кремния [9]. Внутри запрещенной зоны α-Si:Н существует так называемая зона подвижности носителей заряда. В отсутствии дальнего порядка плотность состояний на границах зоны увеличивается, а не обрывается, как это имеет место для монокристалла. Эти пограничные области называют областями Урбаха (Urbach tails). Помимо состояний на границах валентной зоны *E*_v и зоны проводимости *E*_c в α-Si:Н существуют также дополнительные состояния, локализованные внутри запрещенной зоны Eg. Эти состояния называют межзонными распределенными ловушками носителей заряда. Они бывают двух типов. Первый тип ловушек захватывает электроны и не влияет на движение дырок (донорноподобные ловушки); второй тип ловушек захватывает дырки и не оказывает воздействия на электроны (акцептороподобные ловушки). Плотность состояний в аморфном кремнии g(E) определяется суммой плотностей состояний Урбаха и внутризонных ловушек:

$$g(E) = g_{D}^{Urbach}(E) + g_{A}^{Urbach}(E) + g_{D}^{Gauss}(E) + g_{A}^{Gauss}(E).$$
(6)

Плотности состояний Урбаха на границах зоны проводимости и валентной зоны описываются экспоненциальными выражениями:

$$g_{\rm D}^{\rm Urbach}(E) = g_{\rm D\,0}^{\rm Urbach} \exp\left[\frac{E_{\rm V} - E}{E_{\rm D}}\right],\tag{7}$$

$$g_{A}^{Urbach}(E) = g_{A0}^{Urbach} \exp\left[\frac{E - E_{C}}{E_{A}}\right],$$
 (8)

где $g_{D0}^{Urbach}(E)$ и $g_{A0}^{Urbach}(E)$ - плотность состояний Урбаха на границах зоны проводимости и валентной зоны, E_D и E_A – характеристические энергии донорноподобных и акцептороподобных состояний.

Плотность глубоких состояний внутри запрещенной зоны подчиняются распределению Гаусса:

$$g_{\rm D}^{\rm Gauss}(E) = \frac{N_{\rm D}^{\rm Gauss}}{\omega_{\rm D}} \exp \left| -\frac{\left(E - E_{\rm D}^{\rm Gauss}\right)^2}{2\omega_{\rm D}} \right|, \tag{9}$$

$$g_{A}^{Gauss}(E) = \frac{N_{A}^{Gauss}}{\omega_{A}} exp\left[-\frac{\left(E - E_{A}^{Gauss}\right)^{2}}{2\omega_{A}}\right],$$
 (10)

где $E_{\rm D}^{Gauss}$ и $E_{\rm A}^{Gauss}$ - положение вершин распределений Гаусса для донорноподобных и акцептороподобных состояний, $\omega_{\rm D}$ и $\omega_{\rm A}$ - стандартные отклонения для распределений Гаусса, $N_{\rm D}^{Gauss}$ и $N_{\rm A}^{Gauss}$ - число состояний в вершинах распределений Гаусса.

После определения плотности энергетических состояний g(E) в аморфном кремнии (уравнения (6) – (10)) необходимо задать функцию, определяющую вероятность их заполнения носителями заряда. Введем коэффициент *C*, характеризующий отношение сечений захвата заряженных ловушек σ_{ch} и нейтральных ловушек σ_{neut} :

$$C = \frac{\sigma_{ch}}{\sigma_{neut}}, \qquad (11)$$

Для акцептороподобных состояний в аморфном кремнии $\sigma_{ch} = \sigma_p$, $\sigma_{neut} = \sigma_n$ (σ_n и σ_p - сечения захвата электронов и дырок) и функция распределения примет вид [10]:

$$f_{A}(E) = \frac{n + C \cdot N_{v} \exp\left[\frac{(E_{v} - E)}{kT}\right]}{n + p \cdot C + C \cdot N_{v} \exp\left[\frac{(E_{v} - E)}{kT}\right] + N_{c} \exp\left[\frac{(E - E_{c})}{kT}\right]},(12)$$

где N_V и N_C – эффективная плотность состояний в валентной зоне E_V и зоне проводимости E_C , k – постоянная Больцмана, T – абсолютная термодинамическая температура.

Для донорноподобных состояний в аморфном кремнии $\sigma_{ch} = \sigma_n$, $\sigma_{neut} = \sigma_p$ и функция распределения определяется аналогичным выражением:

$$f_{\rm D}(E) = \frac{n \cdot C + N_{\rm V} \exp\left[\frac{(E_{\rm V} - E)}{kT}\right]}{p + n \cdot C + C \cdot N_{\rm C} \exp\left[\frac{(E - E_{\rm C})}{kT}\right] + N_{\rm V} \exp\left[\frac{(E_{\rm V} - E)}{kT}\right]},(13)$$

Определив плотность энергетических состояний в запрещенной зоне аморфного кремния можно оценить концентрацию электронов *n*_{trap} и дырок *p*_{trap}, захваченных акцептороподобными и донорноподобными ловушками Урбаха и межзонными распределенными ловушками. Захваченные носители заряда не вносят вклад в электропроводность. Концентрации *n*_{trap} и *p*_{trap} определяются концентрациями свободных дырок и электронов:

$$n_{trap} = \int_{E_V}^{E_C} f_A(E) g_A(E) dE , \qquad (14)$$

$$p_{trap} = \int_{E_{v}}^{E_{c}} \left[1 - f_{D}(E) \right] g_{D}(E) dE , \qquad (15)$$

здесь

$$g_{\rm D}(E) = g_{\rm D}^{\rm Urbach}(E) + g_{\rm D}^{\rm Gauss}(E) , \ g_{\rm A}(E) = g_{\rm A}^{\rm Urbach}(E) + g_{\rm A}^{\rm Gauss}(E) .$$

При освещении полупроводника светом с энергией фотонов больше ширины запрещенной зоны наблюдается фотогенерация электронно-дырочных пар. Поглощательная способность материала характеризуется коэффициентом поглощения $\alpha(\lambda)$, представленным на рис. 1 [11].





Поток фотонов внутри полупроводника на глубине *x* (координата отсчитывается от поверхности слоя вглубь) определяется соотношением Бугера-Ламберта:

$$\Phi(\mathbf{x},\lambda) = \Phi_0(\lambda) \exp\left[-\alpha(\lambda) \cdot \mathbf{x}\right], \quad (16)$$

Скорость фотогенерации электронно-дырочных пар внутри слоя можно определить как:

$$G(\lambda, x) = -\frac{\partial \Phi(x)}{\partial x} = \alpha(\lambda) \cdot \Phi_0(\lambda) \exp\left[-\alpha(\lambda) \cdot x\right], \quad (17)$$

В случае учета отражения от границы слоя это выражение уточняется:

$$G(\lambda, x) = \frac{\alpha(\lambda) \cdot \Phi_0(\lambda)}{1 - P} \left\{ \exp\left[-\alpha(\lambda) \cdot x\right] + P \exp\left[\alpha(\lambda) \cdot x\right] \right\}, (18)$$

В соответствии с моделью Шокли-Рида-Холла [12] скорости рекомбинации электронов R_n и R_p можно считать равными:

$$R_{n}(n,p) = R_{p}(n,p) = C \cdot \upsilon \sigma_{neut}(n \cdot p - n_{i}^{2}) \times \\ \times \int_{E_{v}}^{E_{c}} \left\{ \frac{g_{D}(E)}{n \cdot C + p + C \cdot N_{C} \exp\left[\frac{\left(E - E_{C}\right)}{kT}\right] + N_{v} \exp\left[\frac{\left(E_{v} - E\right)}{kT}\right]} + \frac{g_{A}(E)}{n + p \cdot C + C \cdot N_{v} \exp\left[\frac{\left(E_{v} - E\right)}{kT}\right] + N_{c} \exp\left[\frac{\left(E - E_{C}\right)}{kT}\right]} \right\} dE, (19)$$

где $\,n_{_{\rm i}}$ - собственная концентрация носителей заряда, $\upsilon\,$ - тепловая скорость движения носителей заряда.

Отметим, что для решения системы уравнений (1) – (5) необходимо также знать плотность электрического заряда *ρ*. Для *α*-Si:H эта величина определяется выражением:

$$\rho = e \left(p - n + p_{trap} - n_{trap} + N_{D}^{+} - N_{A}^{-} \right), \qquad (20)$$

где $N_{\rm D}^{+}$ и $N_{\rm A}^{-}$ - концентрации ионизированных примесных донорных и акцепторных атомов.

Особенность моделирования границы «аморфный – кристаллический» кремний заключается в необходимости учета поверхностной рекомбинации. Плотности электронного и дырочного токов на границе устанавливаются соотношениями:

$$\vec{j}_n\cdot\vec{r}_0=-e\cdot S_n^{surf}\left(n^{surf}-n_0\right), \eqno(21)$$

$$\vec{j}_{p} \cdot \vec{r}_{0} = e \cdot S_{p}^{surf} \left(p^{surf} - p_{0} \right), \qquad (22)$$

здесь \vec{r} - единичный вектор нормали к поверхности, S_n^{surf} и S_p^{surf} - скорости рекомбинации электронов и дырок на рассматриваемой границе, n^{surf} и p^{surf} - концентрации электронов и дырок после пересечения границы.

Вначале определим существенные отличия аморфного кремния от микрокристаллического. Аморфный кремний характеризуется отсутствием пространственного упорядочивания атомов. В микрокристаллическом кремнии кристаллиты Si внедрены в аморфную кремниевую матрицу. Ключевое отличие μ с-Si:H от α -Si:H заключается в наличии большого числа гетерограниц, т.е. микрокристаллический кремний можно рассматривать как материал, обладающий пространственно неоднородными свойствами аморфного кремния и монокристаллического кремния. Наличие гетерограниц с дефектами приводит к появлению внутренних электрических полей, влияющих на электрический транспорт носителей заряда в микрокристаллическом кремнии, но не сказывающихся на общей контактной разности потенциалов *p-n*-перехода. Таким образом, микрокристаллический слой можно заменить комбинацией чередующихся аморфных прослоек и микромонокристаллов кремния. Эксперименты [13] продемонстрировали, что процесс фотогенерации носителей заряда в основном происходит в микрокристаллитах кремния. Поэтому Eg (µс-Si:H) принимается равной Eg (c-Si)=1.12 эВ. Отметим, что для оксидированного µс-Si:O Eg=1.45 эВ. В остальном механизм фотогенерации аналогичен описанному. Образующиеся носители заряда движутся в периодической структуре «микрокристаллы - аморфные слои», что макроскопически приводит к изменению значений подвижностей μ_n и μ_p , коэффициентов диффузии D_n и D_p , а также сечений захвата носителей заряда σ_n и σ_p . Эти параметры для каждого конкретного микрокристаллического кремния определяют экспериментальным путем.

Процесс рекомбинации в μ с-Si:H и μ с-Si:O преимущественно происходит в аморфных прослойках, где имеется высокая плотность состояний g(E). Поэтому для микрокристаллического кремния справедлива модель рекомбинации и захвата носителей заряда аморфного кремния.

Решение уравнений (1) – (5), дополненных соотношениями (6) – (21) проводилось в среде MatLab 7 с помощью разработанной компьютерной программы. Для численного моделирования использовался метод конечных разностей и итерационная схема Ньютона-Рафсона.

4. Типы моделируемых фотопреобразователей

Моделировались три типа ФЭП. Тип I – n-i-p структура на основе µс-Si:H. Тип II – гетероструктура α-Si:H(n)/μс-Si:H(i)/α-Si:H(p). Тип III – предлагаемая нами трехкаскадная структура на основе α-Si:H(*n-i-p*)/ μ с-Si:O(*n*-*i*-*p*)/ μ с-Si:H(*n*-*i*-*p*), обладающая как это будет показано ниже большей эффективностью преобразования солнечной энергии. Конструкции исследуемых структур представлены на рис. 2. Схематически, в конструкциях структур подложки не изображены, так как предполагалось, что каждая из указанных структур располагается на прозрачной диэлектрической подложке (например, стекле), выполняющей роль несущей конструкции. Между активной фотоструктурой и подложкой имеется гальваническая развязка из прозрачного проводящего оксида. Дополнительные слои со стороны фронтального и тыльного контактов отсутствовали. Общая толщина структур І и ІІ типов не превышала 2.5 мкм, III – 6 мкм.

Для моделирования всех параметров и характеристик ФЭП при освещении использовался нормализованныйспектрАМ1.5сплотностьюэнергии100мВт/см². При получении спектров внешнего квантового выхода (*EQE*) структуры *III* - типа внешнее напряжение прямого смещения составляло 0.7 В для верхнего перехода α -Si:Нипо 1 Вдля среднего µс-Si:Оинижнего µс-Si:Н переходов. Концентрация доноров и акцепторов в легированных слоях α -Si:Ни µс-Si:Н не превышала 3·10¹⁹ см⁻³, что обусловлено технологическими трудностями получения более высокого уровня легирования. Туннелирование носителей заряда через границу *p-n* областей предполагалось несущественным. Последовательное и параллельное сопротивления структуры не учитывались. Температура солнечных элементов не менялась и составляла 300 К. Для контактов использовалась модель идеальных омических контактов. Работы выхода электронов принимались равными 4.05 эВ (для μс-Si:H) и 3.8 эВ (для α-Si:H).

Скорость поверхностной рекомбинации электронов и дырок S_n и S_p на границе контактов равнялась 10^7 см/с. При моделировании вольтамперной характеристики структуры III-типа плотность тока короткого замыкания определялась путем конволюции полученной зависимости внешнего квантового выхода и спектра AM 1.5. Затем, по методике [14], определялось напряжение холостого хода и производился расчет остальных параметров структуры (фактора заполнения, КПД). Расчет параметров и характеристик солнечных элементов I - III типов осуществлялся численно.



Рис. 2. Конструкции исследуемых ФЭП: а) µс-Si:H(*n*)/ µс-Si:H(*i*)/µс-Si:H(*p*); б) *a*-Si:H(*n*)/µс-Si:H(*i*)/*a*-Si:H(*p*); в) *a*-Si:H(*n-i-p*)/µс-Si:O(*n-i-p*)/µс-Si:H(*n-i-p*)



На рис. З представлены рассчитанные вольтамперные характеристики образцов *I* и *II*-типов. Кривая *1* соответствует μ с-Si:H (*n-i-p*) солнечному элементу. В *n-i-p* структуре *I*-типа величина напряжения холостого хода U_{xx} достигает 0.571 В и обусловлена значением ширины запрещенной зоны. Фактор заполнения *ff* составил 75.5%. Такой тип структуры имеет весьма низкий КПД и в нашем случае составляет η =7.57%. Введение в конструкцию солнечного элемента на основе μ с-Si:H слоев аморфного кремния позволяет добиться значительного увеличения напряжения холостого хода (кривая 2) за счет увеличения разницы квазиуровней Ферми материалов α -Si:H (E_g=1.72 эВ) и μ с-Si:H (E_g=1.12 эВ).

В ФЭП *II*-типа плотность тока короткого замыкания несущественно снижается до 17.05 мА/см² и в данном случае лимитируется высокой плотностью межзонных распределенных ловушек носителей заряда в α -Si:H (1·10¹⁸ см⁻³/эВ). Фактор заполнения *ff* в структуре *II*-типа оказался выше и достиг 84%. Эффективность фотоэлектрического преобразования увеличилась на 5.13 % и достигла 12.7%. Результаты моделирования указывают на то, что для повышения эффективности фотоэлектрических преобразователей на основе аморфного и микрокристаллического кремния необходимо технологически получать слои аморфного кремния высокого качества с плотностью состояний не выше 10¹⁴-10¹⁶ см⁻³/эВ.



Рис. 3. Зависимости плотности электрического тока от напряжения (вольтамперные характеристики) моделируемых ФЭП /-/// типов

Развивая идею гетероструктурных кремниевых ФЭП и используя результаты работы [3], в которой показана возможность получения оксидированного кремния µс-Si:О с шириной запрещенной зоны Eg≈1.45 эВ, нами предлагается конструкция тонкопленочного трехкаскадного ФЭП α-Si:H(n-i-p)/µc-Si:O(n-i-p)/ µс-Si:H(n-i-p). Моделирование вольтамперной характеристики структуры III-типа (см. рис. 4 – кривая 3) показало, что использование трех каскадов на основе аморфного и микрокристаллического кремния способствует достижению высокого напряжения холостого хода 1.957 В. Фактор заполнения характеристики остается высоким - 78%. Следует отметить, что плотность тока короткого замыкания в трехкаскадной структуре сопоставима с таковой в структуре ІІ-типа и составляет не менее 17 мА/см². Максимальный КПД может достигать 16.3%.

Результаты моделирования спектральной зависимости внешнего квантового выхода каждого каскада структуры и ее интегральное значение для всего ФЭП представлены на рис. 4.



Рис. 4. Зависимости внешнего квантового выхода от длины волны ФЭП, выполненного по α-Si:H(*n-i-p*)/ μc-Si:O(*n-i-p*)/μc-Si:H(*n-i-p*) архитектуре

В коротковолновой области 400-550 нм α-Si:H каскад (кривая 1) характеризуется высоким внешним квантовым выходом 80%. Средний каскад µс-Si: O(n-i-p) структуры III-типа обладает максимальным квантовым выходом 45% (кривая 2) в красной части спектра (600-700) нм. Нижний каскад µс-Si:H(*n*-*i*-*p*) показывает максимальную чувствительность 42% (кривая 3) в ближней ИК части спектра (700-900) нм. Кривая 4 соответствует интегральному внешнему квантовому выходу ФЭП III-типа. Резкий край зависимости на 400 нм обусловлен малой толщиной фронтального слоя α -Si:H(*n*). В видимой части спектра наблюдается высокий внешний квантовый выход (более 80%). В связи с наличием градиента ширины запрещенной зоны Eg (1.72-1.45-1.12 эВ) в диапазоне 700-1100 нм зависимость характеризуется плавным уменьшением внешнего квантового выхода до нуля.

6. Выводы

Предложена конструкция и теоретически исследованы функциональные характеристики кремниевых тонкопленочных трехпереходных ΦЭΠ α-Si: Н(*n-i-p*)/µс-Si:O(*n-i-p*)/µс-Si:H(*n-i-p*) с использованием разработанной программы. Рассмотрена физическая модель электрических и оптических свойств аморфных и микрокристаллических слоев различного типа проводимости и уровня легирования. Проведенный анализ спектральных зависимостей внешнего квантового выхода трехпереходной структуры показывает, что сочетание α-Si:Н и µс-Si:Н n*i-p* переходов позволяет эффективно использовать различные части солнечного излучения и существенно расширить спектральную чувствительность кремниевого гетероструктурного ФЭП в коротковолновом и ближнем ИК диапазоне. Продемонстрирована возможность достижения КПД кремниевых тонкопленочных трехпереходных ФЭП на уровне 16%. Полученные результаты, являются заделом для дальнейших научных и технологических исследований по разработке высоковольтных кремниевых тонкопленочных ФЭП.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (ГК № 14.516.11.0012).

Литература

- Green, M. A. Solar cell efficiency tables (version 41) [Текст] / М.А. Green, K. Emery, Y. Hishikawa, W. Warta, E.D. Dunlop // Prog. Photovolt: Res. Appl. - 2013. - Т. 21. - С.1-11.
- 2. Cousins, P. J. Gen III: improved performance at lower cost [Текст] / P.J. Cousins, D.D. Smith, H.C. Luan. // 35th IEEE PVSC, Honolulu. HI. 2010. C.112-115.
- Benagli, S. High-efficiency amorphous silicon devices on LPCVD-ZNO TCO prepared in industrial KAI-M R&D Reactor [Текст]/ S. Benagli, D. Borrello, E. Vallat-Sauvain // 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference. Hamburg. – 2009. – C. 234-239.
- Чеботарев, С. Н. Моделирование зависимостей функциональных характеристик кремниевых солнечных элементов, полученных методом ионно-лучевого осаждения от толщины и уровня легирования фронтального слоя [Текст] / С.Н. Чеботарев, А.С. Пащенко, М.Л. Лунина // Вестник Южного научного центра РАН. 2012. Т. 7. № 4. С.25-30.
- 5. Лунин, Л.С. Ионно-лучевое осаждение фотоактивных нанослоев кремниевых солнечных элементов [Текст]/ Л.С. Лунин, С.Н. Чеботарев, А.С. Пащенко, Л.Н. Болобанова // Неорганические материалы. 2012. Т. 48. № 5. С.517-522.
- Лунин, Л.С. Моделирование и исследование характеристик фотоэлектрических преобразователей на основе GaAs и GaSb [Текст]/ Л.С. Лунин, А.С. Пащенко // Журнал технической физики. - 2011. - Т. 81. - вып. 9. - С. 71-76.
- Fonash, S. A manual for AMPS-1D for Windows 95/NT a one-dimensional device simulation program for the analysis of microelectronic and photonic structures [Teκcr] / S. Fonash, J. Arch, J. Ciuffi. - Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1997. – 126 c.
- Palankovski, V. Analysis and simulation of heterostructure devices [Текст] / V. Palankovski, R.Quay Wien: Springer-Verlag, 2004. – 289 с.
- 9. Fonash S. Solar cell device physics [Текст] / S. Fonash. New York: Academic Press, 2010. 353 с.
- 10. Carlson, D.E. Semiconductors and Semimetals [Texcr] / Carlson, D.E. Amsterdam: Academic Press, 1984. 385 c.
- Jensen, N. Optimization and characterization of amorphous/crystalline silicon heterojunction solar cells [Tekct] / N. Jensen, R.M. Hausner, R.B: Bergmann // Prog. Photovolt: Res. Appl. - 2002. - T. 10 - C. 1–13.
- Shockley, W. Statistics of the recombination of holes and electrons [Tekct] / W. Shockley, W.T. Read. // Phys. Rev. 1952. T. 87. - c. 835.
- Schropp, R.E.I. Amorphous and microcrystalline silicon solar cells modeling, materials and device technology [Текст] / R.E.I. Schropp and M. Zeman. - Kluwer. Boston/Dordrecht/London, 1998. - 253 с.
- 14. Колтун, М.М. Оптика и метрология солнечных элементов [Текст] / М.М. Колтун М.: «Наука». 1985. 281 с.